

证券代码：300782

证券简称：卓胜微

公告编号：2025-022

江苏卓胜微电子股份有限公司

关于拟为全资子公司向银行申请授信并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 38 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，鉴于经营发展需要，公司全资子公司无锡芯卓湖光半导体有限公司（以下简称“芯卓湖光”）拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。公司将根据各银行及其他金融机构要求，为全资子公司芯卓湖光的综合授信提供相应的担保，担保额度不超过 20 亿元。授信额度及担保额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授信额度及担保额度在期限内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述综合授信额度及担保额度范围内办理具体事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》的规定，本次向银行申请综合授信额度及担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
江苏卓胜微电子股份有限公司	无锡芯卓湖光半导体有限公司	100%	13.76%	0.86	20	20.49%	否

三、被担保人基本情况

名称：无锡芯卓湖光半导体有限公司

成立日期：2023 年 12 月 07 日

注册地点：无锡市滨湖区建筑西路 777(A3)幢 10 层

法定代表人：叶世芬

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：一般项目：集成电路制造，集成电路芯片及产品制造，集成电路销售，集成电路芯片及产品销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司直接持有芯卓湖光 100%股权

关联关系：芯卓湖光是公司的全资子公司，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》界定的关联人

最近一年又一期相关财务数据：

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产（万元）	912,547.21	889,764.96
负债总额（万元）	125,530.31	82,578.89
净资产（万元）	787,016.90	807,186.07
项目	2024 年度 (经审计)	2024 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入（万元）	43,783.49	18,073.27
利润总额（万元）	-42,840.54	-23,765.88
净利润（万元）	-42,840.54	-21,896.42

是否为失信被执行人：否

四、担保协议的主要内容

本次担保事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将以与相关银行等金融机构签署的担保合同或协议内容为准，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。

五、董事会意见

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司向银行申请授信并提供担保的议案》。董事会认为全资子公司芯卓湖光经营状况和资信正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次银行授信及为全资子公司提供担保事项，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，董事会同意上述授信及担保事项。上述担保不提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司担保额度总金额为 20.90 亿元，占公司 2024 年经审计净资产的 20.49%；本次担保提供后，公司及控股子公司的累计对外担保总余额为 20.86 亿元，均为对合并报表内单位的担保，占公司 2024 年经审计净资产的 20.45%。公司及控股子公司不存在为合并报表以外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏卓胜微电子股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日